



## Deutsche IMAPS-Konferenz

9./10. Oktober 2005, München

IMAPS-Deutschland e.V. möchte Sie zur traditionellen 2-tägigen Herbstkonferenz 2006 an der TU-München einladen. Im Rahmen der Konferenz wird neben interessanten Fachvorträgen auf dem Gebiet der Mikroelektronik und der Aufbau- und Verbindungstechnik auch eine begleitende Ausstellung geboten. Wir freuen uns, Sie in diesem Kreise begrüßen zu können. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte aus unseren Internetseiten auf <http://www.imaps.de>.

### Programm

Veranstaltungsort: TU München, Theresienstraße, Theresianum, Hörsaal 0602

**Achtung  
Terminänderung!!**

Montag, 9. Oktober 2006 ←

Thema	Vortragender, Firma, Ort der Firma	
09:00	Einschreibung	
10:00	Konferenzeröffnung	Jens Müller, IMAPS-Deutschland
10:10	Application of photosensitive materials for microvia substrates	Jan Reboun, TU Pilsen
10:35	Nutzenbasierte "bottom-up"-Plattierung von Durchgangsvias mit hohem Aspektverhältnis für flexible Feinleiterschaltungen	Stefan Metz, Dyconex, Bassersdorf, CH
11:00	Cu-gefüllte Microvias für kleinere und zuverlässigere Substrate	Daniel Puschmann, GS Präzisions AG, CH
11:25	Inkjet-Druck zum Aufbringen elektrisch leitender Strukturen	Ulrike Currlé, HSU Hamburg
11:50	Aussteller stellen sich kurz vor (jeweils 2 min)	
12:20	Mittagspause	
13:20	Herausforderungen an die AVT bei OLED-gerechten Montageprozessen	Marcus Detert, ZµP an TU Dresden
13:45	Thermische und strömungsmechanische Simulation einer Leiterplatte im Reflowofen	Johannes Adam, Flomerics, Filderstadt
14:10	Molybdän-Dünnschichten auf LTCC	Ulrich Schmid, Uni Saarland, Saarbrücken
14:35	Kaffeepause	
15:10	Piezokeramische Dickschichten für Sensoren und Aktoren in der Mikrosystemtechnik	Sylvia Gebhardt, IKTS Dresden
15:35	Aufbau- und Verbindungstechnik (AVT) für die Mikrosystemtechnik aus Sicht des Rahmenprogramms „Mikrosysteme“	Paradiso Coskina, Randolf Schließer, VDI/VDE-IT Berlin

**P  
L  
U  
S**

16:00	Herstellung integrierter passiver Komponenten mittels Wafer Level Packaging-Technologien	Kai Zoschke, IZM Berlin
16:25	Ende der Vorträge	
16:30	Mitgliederversammlung	
19:00	Geselliger Abend beim Augustiner	

**Dienstag, 10. Oktober 2006**



09:00	Technologische Realisierung der Flipchipmontage für 60 GHz Verstärkerschaltkreis auf LTCC	Sven Rentsch, TU Ilmenau
09:25	Successful Implementation of Plasma Treatment for Flip Chip Underfill Applications	John Maguire, March Plasma Systems, GB
09:50	Thermal dissipation enhancement in high reliable underfill systems	Y. Homma, Namics, München
10:15	Elektrochemische Sensoren in Dickschichttechnik	Claudia Feller, IKTS Dresden
10:40	Kaffeepause	
11:40	Schichttechnologien für Fine-Line-Strukturen und Widerstände auf gebrannter LTCC	Günter Reppe, RhE, Radeberg
12:05	Anwendung des Designs of Experiments (DOE) für den Laserabgleich von Widerständen auf LTCC	Rainer Dohle, MSE, Berg
12:30	Pb-freies Pastensystem Dickschicht	John Whitmarsh, ESL, GB
12:55	Neue umweltfreundliche Dickschichtpasten für die Elektronikindustrie	Matthias Metzner, Ferro, Hanau
13:20	Schlussworte	Jens Müller, IMAPS-Deutschland
13:25	Ende der Veranstaltung	

**PLUS**

### **Begleitende Ausstellung zur Konferenz**

Nach den positiven Resonanzen auf den letzten Veranstaltungen möchten wir auch diesmal allen interessierten Firmen die Möglichkeit geben, auf kleinen Ständen parallel zur Vortragsveranstaltung ihre Produkte (kleine Geräte, Muster, Dokumentationen) zu präsentieren.

#### *Standgröße und -ausstattung:*

- ca. 6 m<sup>2</sup>
- Tisch (ca. 120 cm x 80 cm)
- Pinwand (ca. 120 cm x 120 cm)
- 2 Stühle
- 230 V-Anschluß

#### *Informationen und Reservierung:*

Wenn Sie noch Fragen zur begleitenden Ausstellung haben, so wenden Sie sich bitte an:

Jens Müller, Fax 03677/693379, jens.mueller@imaps.de

Anmeldungen zur Ausstellung können Sie ab sofort durchführen. Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der Plätze begrenzt ist. Anmeldungen zur Ausstellung werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt!

### **Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung der IMAPS-Deutschland e.V.**

*9. Oktober 2006, 16:30 Uhr, Technische Universität München, Hörsaal 0602, Theresianum*

Die Mitgliederversammlung findet im Anschluss an den ersten Tag unserer Vortragsveranstaltung am gleichen Ort statt.

## Tagesordnung

1. Abschlußbericht 2005 des Vorstandes
2. Abschlußbericht 2005 des Schatzmeisters
3. Entlastung von Vorstand und Schatzmeister
4. Wahlen (2. Vorsitzende(r) und Schatzmeister)  
Wahlvorschlag des Vorstandes:  
2. Vorsitzende: Dr. Gisela Dittmar  
Schatzmeister: Prof. Wolfgang Radlik
5. Vorläufiger Bericht 2006 des Vorstandes
6. Vorläufiger Bericht 2006 des Schatzmeisters
7. Vorschau auf 2007
8. Verschiedenes

**Wahlvorschläge** können bis unmittelbar vor der Wahl an Prof. Dr. Walter Hansch, TU München, Lehrstuhl für Technische Elektronik, D-80333 München gerichtet werden.

Wir bitten um zahlreiches Erscheinen und hoffen auf eine lebhaftige Mitgliederversammlung.

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung findet traditionsgemäß ein **gemeinsames Abendessen** in den Augustiner Gaststätten, Neuhauser Str. 16, erster Stock, Grüner Saal, etwa ab 19:00 Uhr statt. Die Gaststätte liegt zwischen Karlsplatz und Marienplatz.

Mitglieder, die nicht an der Konferenz teilnehmen, sind zum Abendessen gegen Zahlung eines Unkostenbeitrages von 30,- € herzlich eingeladen. Für Konferenzteilnehmer ist das gemeinsame Abendessen kostenlos.

Mit freundlichen Grüßen  
der Vorstand der IMAPS-Deutschland e.V.

Dr. Jens Müller

## Berliner Kamingsprache zur Mikrosystemtechnik

*Nachdenken? Ja, aber auch Vordenken!*

Innovationsverläufe im Bereich von Hochtechnologie sind von einer hohen Dynamik gekennzeichnet. Das Aufspüren von Zukunftsszenarien ist daher vergleichbar einer Fahrt mit dem Auto in eine Nebelbank, wobei sich der Fahrer durch den Blick aus dem Seitenfenster und in den Rückspiegel orientiert. Es findet eine Extrapolation gegenwärtig bekannter Entwicklungslinien in die Zukunft statt; Sprunginnovationen sind kaum vorhersehbar. Dennoch ist „Foresight“ – also die „Vorausschau“ – ein wichtiges Instrument, um Trends und damit verbundene Gestaltungsoptionen zu durchdenken. Kurzfristige Vorausschauen und sich daraus abzeichnende Anforderungen an Innovationsprozesse ermöglichen es, die strategische Orientierung staatlicher Maßnahmen regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu modifizieren.

Eine mittel und langfristige Vorausschau eröffnet hingegen neue Anwendungskorridore, in denen sich gesellschaftlich erwünschte Ziele neu formulieren lassen. Technologieoptionen, gesellschaftliche Bedürfnisse und wirtschaftliche Interessen oder auch Notwendigkeiten zeichnen gemeinsam das Bild möglicher Zukunftsszenarien.

Im Auftrag des *Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)* fertigt die *VDI/VDE Innovation + Technik GmbH (VDI/VDE-IT)* mit ausgewählten Partnern einzelne Bestandteile oder Episoden eines Zukunftsgemäldes zum Thema *Mikrosystemtechnik (MST)* an. Dabei haben sich die Akteure als Innovationslotsen für MST-affine Technologielinien und visionäre Anwendungen gezeigt. Die Grenze zur Science Fiction wurde dabei bewusst nicht überschritten, weil sich alle Beteiligten einig darin sind, dass die Zukunftsentwürfe durchaus Industrie-relevant und damit Stimuli für die Industrie und für eine gemeinsame Diskussion über die Frage „Wie erreichen wir erwünschte Ziele?“ sein sollten. Die Darstellung von Visionen in MST-relevanten Anwendungsbereichen kann nicht die Unsicherheiten über Märkte sowie über technische und unternehmerische Anforderungen restlos beseitigen. Diese kann aber dennoch Unternehmen Impulse für einen begründeten Einstieg in neue Technologie- oder Produktstrategien geben, wenn seriös erarbeitete Zukunftsszenarien die hohe Bedeutung der Mikrosystemtechnik für die Wirtschaft in für Deutschland wichtigen Feldern aufzeigen. Unter Beteiligung nationaler Experten und international herausragender Persönlichkeiten wurden interessante Aspekte diskutiert.

Im Dezember 2005 wurde zur Thematik *Food Chain Management* und im Februar 2006 zum Thema *Mikro-Nano-Integration* zwei mehrtägige Veranstaltungen durchgeführt. Die Dokumentation können unter folgender Internet-Adresse eingesehen werden:

[http://www.vdivde-it.de/publikationen/studien\\_html](http://www.vdivde-it.de/publikationen/studien_html)

## EPoSS – neue Technologieplattform zum Thema Smart Systems Integration

Der offizielle Startschuss für die neue europäische Technologieplattform *EPoSS* in Brüssel ist jetzt gefallen. Mit dem Schwerpunkt *Smart Systems* und *Mikro-Nano-Integration* bietet *EPoSS* der Community ein anwendungsübergreifendes Informationsnetzwerk und bringt dabei sowohl öffentliche, als auch industrielle Interessenvertreter zusammen. *EPoSS* zielt darauf ab, dauerhafte Strukturen und Initiativen zur Förderung der Europäischen Innovationspolitik und Forschungslandschaft zu etablieren.

[www.smart-systems-integration.org/public](http://www.smart-systems-integration.org/public)

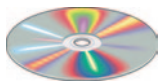
## Veranstaltungskalender

Ort	Zeitraum	Name	Veranstalter
Kraków, Polen	24.-27. 9. 2006	30 <sup>th</sup> International IMAPS Poland Conference & Exhibition	IMAPS Poland
Besançon, Frankreich	26.-29. 9. 2006	Interconex 2006	IMAPS France
Ilmenau	8. 2. 2007	IMAPS-Seminar	IMAPS Deutschland
Oulu, Finnland	17.-20. 7. 2007	EMPC 2007 – 16 <sup>th</sup> European Microelectronics and Packaging Conference & Exhibition	IMAPS Nordic

**PLUS**

### Noch zu haben: Proceedings

Die Proceedings des *Deutschen IMAPS-Seminars 2006*, das am 9. Februar 2006 in Göppingen zum Thema *Muss jeder Sensor smart sein?* stattfand, können auf CD zum Preis von



€ 55,-

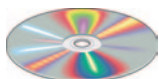
und als Papierausdruck zum Preis von



€ 110,-

erworben werden.

Auch die Proceedings der *Herbsttagung 2005*, die am 10. und 11. Oktober 2005 in München durchgeführt wurde, sind noch als CD zum Preis von



€ 55,-

erhältlich.

Richten Sie bitte Ihre Bestellungen an:

*Prof. Dr. Wolfgang Radlik, c/o FH Rosenheim, Hochschulstraße 1, D-83024 Rosenheim, Fax 08031/805-603, wolfgang.radlik@imaps.de*

Bitte beachten Sie, dass der angegebene Preis gemäß § 4 Nr. 22 UstG umsatzsteuerfrei ist und die verfügbare Anzahl begrenzt ist.

### Internet-Auftritt von IMAPS Deutschland

Sie finden die Webseiten von IMAPS Deutschland im Internet unter

<http://www.imaps.de>

Hier erhalten Sie aktuelle Informationen über Veranstaltungen und Ansprechpartner von *IMAPS Deutschland e.V.* Darüber hinaus können Sie dort auch Ihre Mitgliedschaft beantragen. Über Kritik und Anregungen, aber auch inhaltlichen Input würde sich der Vorstand sehr freuen.

Die internationalen Seiten von IMAPS erreichen Sie unter

<http://www.imaps.org>

### Kontakte und Adressen des IMAPS-Vorstandes

Dr.-Ing. Jens Müller

1. Vorsitzender

c/o ZiK MacroNano

Applikationszentrum Ilmenau

Gustav-Kirchhoff-Straße 5

98693 Ilmenau

Fon: 03677/69-3381

Fax: 03677/69-3379

e-mail: [jens.mueller@imaps.de](mailto:jens.mueller@imaps.de)

Dr.-Ing. Gisela Dittmar

2. Vorsitzende

c/o Ingenieurbüro Elektroniktechnologie

Egerlandstraße 88

D-73431 Aalen

Fon: 07361/931129

Fax: 07361/943004

e-mail: [gisela.dittmar@imaps.de](mailto:gisela.dittmar@imaps.de)

Prof. Dr. Wolfgang Radlik

Schatzmeister

c/o FH Rosenheim

Hochschulstraße 1

D-83024 Rosenheim

Fon: 08031/805-629

Fax: 08031/805-603

e-mail: [wolfgang.radlik@imaps.de](mailto:wolfgang.radlik@imaps.de)

Prof. Dr.-Ing. Matthias Fischer  
Schriftführer  
c/o FH Schmalkalden  
FB Elektrotechnik  
D-98574 Schmalkalden  
Fon: 03683/688-5116  
Fax: 03683/688-5499  
e-mail: matthias.fischer@imaps.de

Dipl.-Phys. Rolf Aschenbrenner  
Öffentlichkeitsarbeit  
c/o Fraunhofer Institut Zuverlässigkeit  
und Mikrointegration  
Chip Interconnection Technologies  
Gustav-Meyer-Allee 25  
D-13355 Berlin  
Fon: 030/46403-164  
Fax: 030/46403-161  
e-mail: rolf.aschenbrenner@imaps.de

Dipl.-Ing. Thomas Bartnitzek  
Öffentlichkeitsarbeit  
c/o VIA electronic GmbH  
Robert-Friese Straße 3  
D-07629 Hermsdorf  
Fon: 036601/81-529  
Fax: 036601/81-530  
e-mail: thomas.bartnitzek@imaps.de

Dipl.-Ing. Paradiso Coskina  
Öffentlichkeitsarbeit  
c/o VDI/VDE Innovation + Technik GmbH  
Steinplatz 1  
D-10623 Berlin  
Fon: 030/310078-242  
Fax: 030/310078-256  
e-mail: paradiso.coskina@imaps.de

Dr.-Ing. Karl-Heinz Drüe  
Öffentlichkeitsarbeit  
c/o TU Ilmenau  
Fakultät EI  
FG Mikroperipherik  
PF 100565  
D-98684 Ilmenau  
Fon: 03677/69-3429  
Fax: 03677/69-3350  
e-mail: karl-heinz.drue@imaps.de

Ernst Eggelaar  
Öffentlichkeitsarbeit  
c/o Microtronic Microelectronic Vertriebs GmbH  
Klein Grötzing  
D-84494 Neumarkt-St. Veit  
Fon: 08722/9620-0  
Fax: 08722/9620-30  
e-mail: ernst.eggelaar@imaps.de

Prof. Dr.-Ing. Heinz Osterwinter  
Öffentlichkeitsarbeit  
c/o FHTE Standort Göppingen  
Robert-Bosch-Str. 1  
D-73037 Göppingen  
Fon: 07161/679-157  
Fax: 07161/679-233  
e-mail: heinz.osterwinter@imaps.de

Dr. Martin Oppermann  
Öffentlichkeitsarbeit  
EADS Deutschland GmbH  
Microwave Factory / Defence Electronics  
Woerthstr. 85  
D-89077 Ulm  
Fon: 0731/392-3879  
Fax: 0731/392-3362  
e-mail: martin.oppermann@imaps.de